



2025.06.04

반도체 EDA까지 번진 미-중 수출 규제

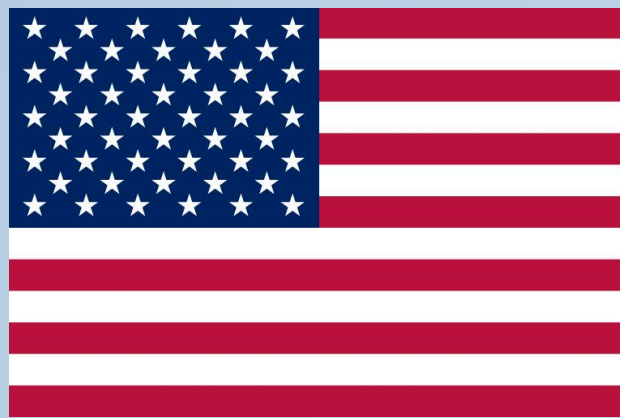
미국이 반도체 EDA 3사에 중국 수출 규제에 대한 정식 서한을 보냈습니다.

샤오미, 3nm 공정 모바일 AP 발표

샤오미의 새로운 모바일 AP인 XRING 01은 TSMC의 선단 3nm 공정으로 제작됩니다.

중국 상무부, EU와 반도체 관련 회담 진행

지난달, 중국 상무부와 EU가 반도체 공급 사슬에 대해 논의하는 좌담회를 가졌습니다.



SYNOPSYS®

cādence

SIEMENS

Image credit : Wikipedia

반도체 EDA까지 번진 미-중 수출 규제

- 국 상무부 산업안보국은 시놉시스, 케이던스, 지멘스 EDA 등 글로벌 EDA 소프트웨어 기업들에 중국 기업과의 거래를 즉각 중단하라는 공식 서한을 발송했습니다.
- 이는 반도체 제조 이전 단계인 설계 툴까지 규제 범위를 넓힌 조치입니다.
- 이러한 조치는 단기적으로는 중국의 첨단 반도체 설계에 장벽으로 작용하겠으나, 장기적으로는 중국의 EDA 기술 자립화를 가속화 시킬 것으로 보입니다.

xiaomi



Image credit : Xiaomi

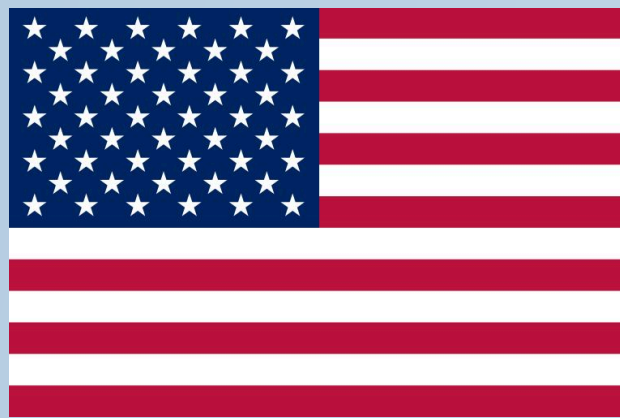
샤오미, 3nm 공정의 모바일 AP 발표

- 샤오미는 자체 설계한 3nm 모바일 AP 'XRING O1'을 공개하며 프리미엄 칩 개발에 나섰습니다.
- 이 칩은 TSMC의 최첨단 3nm 공정을 사용해 제조되었습니다.
- 모바일 공정의 경우 미국의 규제 범위를 벗어나 있으며, 이를 이용해 중국은 프리미엄 모바일 SOC 내재화에 속도를 내고 있습니다.



중국 상무부, EU와 반도체 관련 회담 진행

- 중국 상무부는 유럽 주요 인사들과 반도체 공급망 협력을 주제로 좌담회를 개최했습니다.
- 양측은 반도체 산업 내 기술, 자원, 정책 차원의 협력 가능성을 논의했습니다.
- 중국은 미·중 갈등 속에서 미국의 압박에 대응하고자 유럽과의 전략적 협력을 확대하고 있습니다.



SYNOPSYS®

cādence

SIEMENS

Image credit : Wikipedia

US Expands Export Controls to EDA

- The U.S. BIS has formally ordered global EDA firms to immediately halt transactions with Chinese companies.
- This marks a strategic expansion of restrictions from manufacturing tools to design-level software.
- China faces even greater hurdles in developing advanced chip.

xiaomi



Image credit : Xiaomi

Xiaomi Unveils 3nm Mobile AP

- Xiaomi has introduced its own 3nm mobile application processor, 'XRING 01'.
- The chip is manufactured using TSMC's advanced 3nm node, highlighting Xiaomi's push into premium SoCs.
- Chinese firms are accelerating efforts to internalize mobile tech.



China–Europe Strategic Dialogue

- China's Ministry of Commerce hosted a dialogue with European leaders on semiconductor supply chain cooperation.
- The two sides discussed potential collaboration in Chip industry.
- China is seeking to deepen strategic ties with Europe as US-China tech tensions persist.